

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-013

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☒其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、常春藤资产、天演论资本、道仁资产、真科基金、伊诺尔集团、富安达基金
会议时间	2025 年 9 月 24 日
会议地点	上海
上市公司接待人员姓名	副总经理：石新华 证券事务代表：彭芹芹
投资者关系活动主要内容介绍	Q1、公司在功率半导体领域业务进展情况如何？ A1、超声波焊接技术凭借为高功率模块如 IGBT 提供更优异的电气性能和机械可靠性，应用场景更加普及。在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波 PIN 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。在该领域，公司与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、士兰微、芯联集成等知名企业保持良好合作。 Q2、请问公司超声波检测与其他检测方式的区别和优势？ A2、在半导体先进封装领域，超声波检测与光学检测、X 射线等检测技术互为补充。超声波检测的核心优势在于其穿透能力和对内部界面缺陷的无损量化能力，尤其在半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等关键工艺中的内部缺陷问题。光学

	检测、电子束检测等适用于工件表面缺陷检测；超声波检测与 X 射线则能够检测工件内部缺陷，X 射线检测的优势在于检测存在密度差异的缺陷，超声波检测则对声阻抗差异敏感，对于内部的平面型缺陷或界面缺陷，如裂纹、未熔合、界面分层等情况，超声波的反射特性优势明显，超声波在界面会大量反射，产生极其强烈的回波信号，利用界面声阻抗差异，超声波检测技术可精准、无损伤地探测出半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等内部缺陷。 Q3、请问配件是否必须适用公司设备？ A3、出于设备与配件运行的匹配性与稳定性的考虑，公司所销售的超声波设备在替换配件时仍主要使用公司生产并销售的焊头、裁刀、发生器、换能器等配件，配件专用性较强，客户黏性较高。 Q4、公司毛利率提升的原因？ A4、2025 年上半年度，受益于产品结构变化，毛利率较高的产品收入占比提升，以及公司加强经营管理，通过技改等措施积极降本增效，不断提高运营管理效率，公司产品综合毛利率进一步提升至 65%。 Q5、请问超声波固晶机等产品进展情况？ A5、公司积极布局 IC 封装领域，着力研发高端超声波固晶机及球焊机。超声波球焊机运用超声波焊线技术，通过施加压力、热与超声，使微细金线精准连接 IC 芯片电极与框架焊盘，完成芯片封装前的内部引线焊接。依托公司在超声波领域多年技术积淀与经验丰富的研发团队，目前该设备设计与开发工作进展顺利，旨在突破海外厂商在该领域的长期垄断局面。 Q6、公司固晶机与传统固晶机的区别以及超声波固晶有哪些优势？ A6、传统固晶机主要依赖外部加热和机械压力实现机械连接和电气连接。超声波固晶机则在此基础上进一步引入了超声波
--	--

	能量,在压力下超声波振动传递到芯片与基板的接触界面使金属原子间相互扩散,形成牢固的金属键合。与传统工艺相比,公司超声波热压固晶机采用自主创新的超声波键合技术,通过高频超声波振动,在芯片与基板界面处产生局部加热并清除表面氧化物,促使材料原子级扩散和接触。在超声能量与精确压力协同作用下,界面发生塑性形变和原子扩散,形成牢固的金属键合,大幅提升封装可靠性和生产效率。公司超声波热压固晶机仅需较低预加热温度,即可实现优质键合效果,可以降低热敏感元件损伤风险,具有效率高、能耗低等显著优势,在光通讯、5G 射频、滤波器、激光器、分立器件、存储、AR/VR、MEMS 等领域具有较大的应用前景。 Q7、线束连接器使用超声波焊接的优势? A7、线束连接器生产工艺主要有压接和超声波焊接两类,压接工艺存在金属冲压反弹风险且易在线束内部形成空洞,恶劣工况下还存在氧化和生锈风险,导致压接位置的电阻系数提升、导电性降低;超声波焊接是利用超声波振动所产生的物理效应将线头结合起来,焊后内阻极低,不仅保证了焊接位置的密实度,有利于防止截面空洞问题,而且大大提升线束的电气连接能力。在线束连接器领域,公司超声波焊机主要应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等,与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺、住友等以及比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、长春捷翼、华丰科技、永贵电器、天海电器、立讯精密、沃尔核材等知名企业保持良好合作。随着下游汽车电动化与智能化、新能源、数据中心等应用行业需求增长,为上游超声波设备厂商提供了良好的发展机遇。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 24 日